

## 貳、公司簡介

---

一、設立日期：86年5月15日

### 二、公司沿革

- 86年** 05月-- 力成科技股份有限公司成立，實收資本額6億元整。  
08月-- 取得力晶半導體 DRAM、旺宏電子 FLASH 測試訂單，開始記憶體積體電路測試服務。
- 87年** 02月-- 經財政部證券暨期貨管理委員會核准公開發行。  
05月-- 通過 ISO 9002 品質管理系統驗證(測試)。
- 88年** 01月-- 金士頓集團(Kingston Group)蔡篤恭先生接任董事長。
- 89年** 10月-- 購入力晶半導體竹北分公司後段設備，增加封裝業務，開始提供客戶封裝測試一元化服務。
- 90年** 01月-- 取得掛牌為保稅工廠。  
05月-- 通過 ISO 9002：1994 品質管理系統驗證(封裝、測試)。
- 91年** 03月-- 通過 TOSHIBA 封裝及測試品質認證，取得 TOSHIBA FLASH 封裝測試訂單，提供 TOSHIBA 封裝測試一元化服務(Turn-Key Service)。  
10月-- 股票於興櫃市場掛牌交易。
- 92年** 01月-- 榮獲 ISO 14001：1996 環境管理系統驗證合格。  
04月-- 股票於櫃檯買賣中心掛牌交易。  
08月-- 通過 ISO 9001：2000 品質管理系統驗證。
- 93年** 09月-- 通過 OHSAS 18001：1999 安全與衛生管理系統驗證。  
11月-- 公司股票於台灣證券交易所掛牌交易。  
-- 晶圓級測試正式進入量產。
- 94年** 02月-- 導入綠色產品(GP)管理系統。  
05月-- 通過 Sony Green Partner 驗證。  
12月-- 以「購買法」簡易合併 100%轉投資之力嘉投資有限公司。  
-- 開始生產 microSD Card。  
-- 通過 ISO 14001：2004 環境管理系統驗證。
- 95年** 01月-- 研發技術中心成立。  
-- 首次發行權全球存託憑證(現股)於盧森堡證券交易所掛牌交易。  
08月-- 通過 ISO/TS 16949：2002 驗證。  
12月-- 榮獲經濟部技術處「95年產業創新成果表揚」。

96年 03月-- 發行第一次私募國內無擔保可轉換公司債，發行金額新台幣 34 億 1 仟 2 百萬元。

08月-- 獲得經濟部國際貿易局「95年度金貿獎」出進口實績第十名。

11月-- 榮獲經濟部工業局「第八屆工業精銳獎」。

97年 03月-- 開始提供邏輯 IC 封裝服務。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「96年度金貿獎」出進口實績第九名。

98年 08月-- 榮獲經濟部國際貿易局「97年度金貿獎」出進口實績第五名。

09月-- 透過海外子公司 Powertech Holding (B.V.I.) Inc.併購 Spansion Holdings (Singapore) Pte. Ltd.(更名為 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.)並間接取得 Spansion 中國蘇州 MCP 封測廠，後更名為力成科技(蘇州)有限公司，正式跨足大陸地區的封裝測試領域。

99年 03月-- 於新竹科學園區成立子公司-聚成科技股份有限公司。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「98年度金貿獎」出進口實績第五名。

-- 榮獲經濟部技術處第 18 屆產業科技發展獎之「傑出創新企業獎」。

100年 08月-- 榮獲行政院頒發「創造就業貢獻獎」。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「99年度金貿獎」出進口實績第六名。

101年 02月-- 透過公開收購取得超豐電子股份有限公司股權 44%。

04月-- 經超豐電子股東臨時會改選，力成正式入主超豐電子。

102年 07月-- 主要客戶爾必達公司被美光科技收購，業務對象變更為美光科技。

09月-- 榮獲經濟部國際貿易局「101年度金貿獎」出進口實績第十名。

11月-- 湖口 3C 新廠落成啟用，並將總公司遷址於此。

103年 02月-- 與美商 TESSERA 達成技術授權合約之訴訟和解，並同意提前終止授權合約，有助於本公司未來代工業務成本的降低。

07月-- 取得新加坡 Nepes Pte. Ltd. 100% 股權，並更名為 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.。

12月-- 與美光科技簽訂半導體封裝投資合約，本公司未來將於中國大陸西安設立封裝廠，提供封裝服務。

-- 吸收合併子公司「聚成科技股份有限公司」，並於原址改設竹科分公司。

104年 04月-- 正式加入電子行業公民聯盟(EICC)(現更名為責任商業聯盟 RBA)。

05月-- 設立子公司-力成半導體(西安)有限公司。

- 105 年 04 月-- 榮獲經濟部國際貿易局「104 年度金貿獎--最佳貿易貢獻獎」第四名。
- 10 月-- 取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會「2016 台灣 Top 50 企業永續報告獎—電子資訊製造業金獎」。
- 12 月-- 取得社會責任管理系統(SA8000)認證。
- 106 年 01 月-- 設立日本子公司--力成科技日本合同會社(Powertech Technology (Japan) Limited)。
- 應募人紫光集團實質控制公司--西藏拓展創芯投資有限公司未能於規定期限內取得主管機關許可，致本公司與紫光集團有限公司、西藏拓展創芯投資有限公司合意終止之前所簽訂之私募普通股認股協議。
  - 加入「台灣永續供應協會 TASS」，將參與該協會協助經濟部工業局完成「台灣封測產業綠色環安雲端應用發展計畫」。
- 04 月-- 與 Micron Technology Inc.(美光科技)簽署合約，計畫以公開收購方式取得其日本子公司所持有日本上市公司 Tera Probe Inc. 39.6%之持股，暨併購其位於日本秋田的封裝測試廠 Micron Akita Inc.(美光秋田株式會社)之 100%股份。
- 06 月-- 完成公開收購日本上市公司 Tera Probe Inc.之股權，合計持股達 59.44%，正式成為力成子公司。
- 08 月-- 完成併購 Micron Akita Inc.(美光秋田株式會社)100%股份，並更名為 Powertech Technology Akita Inc.(力成科技秋田株式會社)。
- 11 月-- 獲頒台灣永續能源研究基金會「2017 Top 50 企業永續報告 金獎」。
- 107 年 01 月-- 榮獲英國媒體路透社母公司湯森路透 (Thomson Reuters) 列入「全球百大科技領袖」(Top 100 Global Technology Leaders) 優秀企業名單。
- 09 月-- 力成新竹科學園區三廠開始興建，啟動全球第一座使用面板級扇外型封裝(Fan-Out Panel-Level Packaging, FOPLP) 製程之量產基地，正式佈局高階封裝領域。
- 11 月-- 力成董事會委任蔡篤恭董事長兼任策略長，洪嘉銓總經理兼任執行長。
- 獲頒台灣永續能源研究基金會第十一屆 TCSA 台灣企業永續獎之「Top 50 企業永續報告 白金獎」及「Top 50 台灣企業永續獎」。